(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005年5月12日(12.05.2005)

PCT

(10) 国際公開番号

(51) 国際特許分類7:

WO 2005/043247 A1

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/013354

G03F 7/039, 7/022

(22) 国際出願日:

2004年9月14日(14.09.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-373069

2003年10月31日(31.10.2003) JP

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): AZ エレクトロニックマテリアルズ株式会社 (AZ) ELECTRONIC MATERIALS (JAPAN) K.K.) [JP/JP]; 〒1130021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号文 京グリーンコート Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 牧井 利道 (MAKII, Toshimichi) [JP/JP]; 〒4371496 静岡県小 、笠郡大東町千浜3810 クラリアント ジャパン 株式会社内 Shizuoka (JP). 西脇 良典 (NISHIWAKI, Yoshinori) [JP/JP]; 〒4210301 静岡県榛原郡吉田町住 吉5402-8 メゾンプラージュA202 Shizuoka (JP). 明石 一通 (AKASHI, Kazumichi) [JP/JP]; 〒 4371496 静岡県小笠郡大東町千浜3810 クラリア ント ジャパン 株式会社内 Shizuoka (JP).

- (74) 代理人: 鐘尾 宏紀. 外(KANAO, Hiroki et al.); 〒 1010063 東京都千代田区神田淡路町 2 丁目 1 0 番 14号 ぱんだいビル2階 むつみ国際特許事務所 千 代田オフィス Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可 能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: THICK FILM OR ULTRATHICK FILM RESPONSIVE CHEMICAL AMPLIFICATION TYPE PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION

(54) 発明の名称: 厚膜および超厚膜対応化学増幅型感光性樹脂組成物

(57) Abstract: A chemical amplification type photosensitive resin composition comprising an alkali soluble novolak resin (A), a resin or compound which itself is insoluble or hardly soluble in an alkali but becomes soluble in an alkali by the action of an acid (B), an acid generator (C) and a photosensitive agent having a quinonediazido group (D) optionally together with an alkali soluble acrylic resin (E) and a crosslinking agent for film quality improvement (F). This chemical amplification type photosensitive resin composition is a thick film or ultrathick film responsive photosensitive resin composition and is preferably used as a resist for forming a bump for use as a magnetic pole of magnetic head or a terminal for LSI connection. v

(A) アルカリ可溶性ノボラック樹脂、(B) それ自身はアルカリに不溶または難溶であるが、酸の作 □ 用によりアルカリに可溶となる樹脂または化合物、(C)酸発生剤、(D)キノンジアジド基を含む感光剤、およ び必要に応じ(E)アルカリ可溶性アクリル系樹脂および(F)膜質改善のための架橋剤を含有する化学増幅型感 光性樹脂組成物。この化学増幅型感光性樹脂組成物は、厚膜並びに超厚膜対応感光性樹脂組成物であり、磁気ヘッ ドの磁極やLSIの接続用端子として用いられるパンプを形成する際のレジストとして好ましく用いられる。

